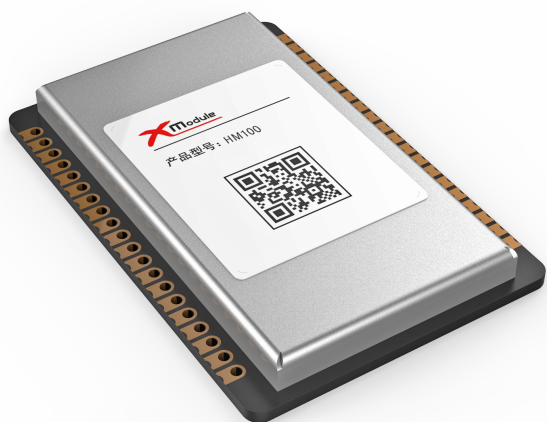
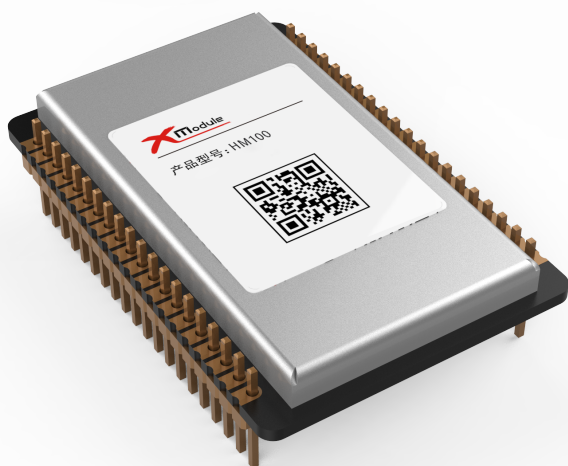




HM100 带外管理模块

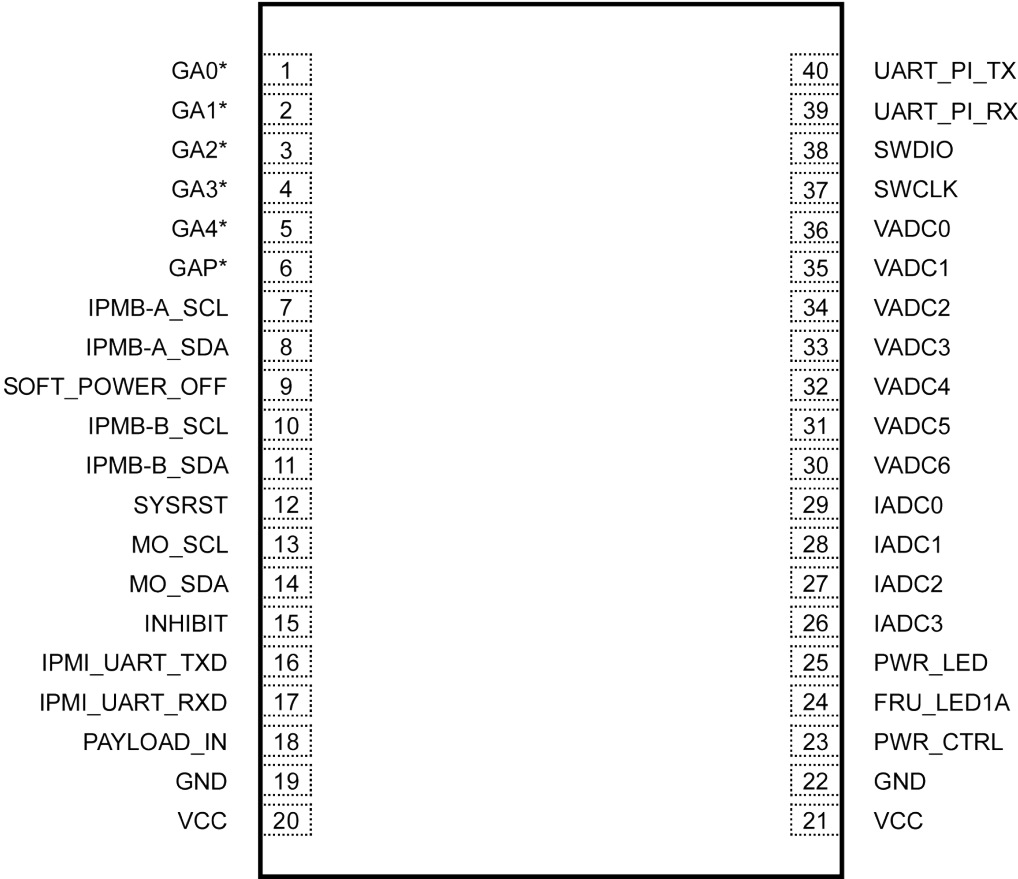


HM100为支持IPMI2.0接口协议的小型化带外管理模块，支持上下电控制、温度检测、电压检测、电流检测、处理器资源状态信息获取、健康信息上报及告警等功能；模块采用双冗余备份IPMB管理总线设计，支持11路ADC接口、1路数据通信串口、1路IIC数据通信口、1组槽位地址检测口、5路上下电检测控制口、2路状态指示信号输出以及1路调试串口。

模块尺寸为30mm×20mm×3mm（长×宽×高），同时支持半月孔焊接方式和排针插拔安装方式；模块元器件的国产化率可以实现“穿透式”数量和种类双100%，能够广泛应用于遵循ATCA、CPCI、PXIe、VPX、ASAAC规范研制的电源刀片、计算刀片、交换刀片等各类工控板卡。



HM100 带外管理模块 | 示意图



关键特点

支持标准IPMI2.0
通信协议

双冗余IPMB接口,
更可靠

体积小, 可用于各类
限高3mm板卡背面

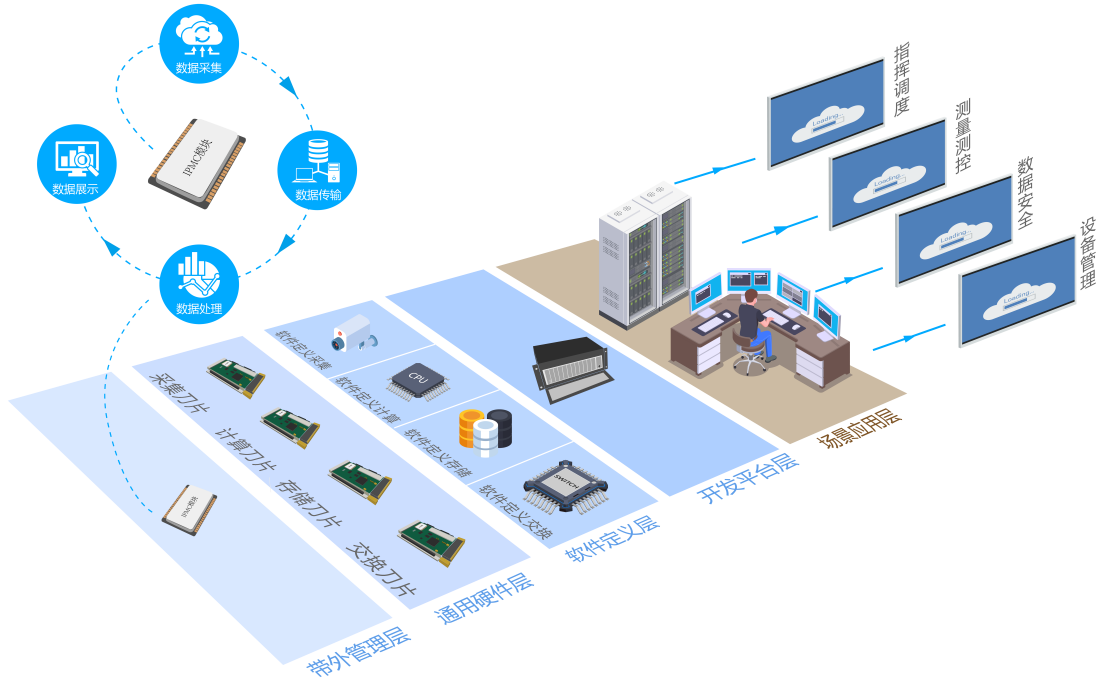
功耗低, 无需额外
散热器件

可配置性强
提供图形化界面用
户自行配置

穿透式100%
国产化

HM100 带外管理模块 | 应用场景

- ★ 计算类板卡带外控制及健康管理
- ★ 电源类板卡带外控制及健康管理
- ★ 交换类板卡带外控制及健康管理
- ★ VPX机箱整机健康管理应用



规格参数

硬件平台	
处理器	ARM处理器
存储	支持外挂EEPROM，配置管理信息存储

软件平台	
操作系统	嵌入式实时操作系统
配置界面	支持通过上位机进行端口配置
软件升级	本地升级
	远程升级

接口协议	IPMI2.0
物理接口	双冗余备份IPMB管理总线
ADC接口	ADC×11
数据通讯串口	数据通讯串口×1
数据通讯口	数据通讯口×1
地址检测口	地址检测口×1
电检测控制口	电检测控制口×5
调试串口	调试串口×1

供电	
供电	3.3V@≤1W

物理参数	
重量	≤50g
尺寸	半月孔焊接型模块30mm×20mm×3mm
	排针焊接型模块30mm×20mm×8mm
外壳	洋白铜C7521-H

环境参数	
温度等级	商业级 (0℃~70℃)
	工业级 (-40℃~80℃)

国产化率	
国产化率	国产化元器件数量及种类比例均为95%
	国产化元器件数量及种类比例均为100%